주식회사 브이・에스・테크놀로지

2020 년 9 월 11 일

1000～1600nm 투과율을 높인 Telecentric Lens VS-THV-SWIR Series 판매 개시

주식회사 브이・에스・테크놀로지는 1000～1600nm 의 투과율을 높인 Telecentric Lens VS-THV-SWIR 시리즈를 판매 개시하였습니다. SWIR 카메라의 보급이 진행되어 반도체 검사 용도로 SWIR 대응 렌즈가 요구되는 가운데, 본 제품은 가시광 설계의 Telecentric Lens 에 비해 근적외 대역에서 투과율이 4 배, 근적외를 이용한 시스템에 있어서 광량을 확보하며 택트타임 향상에 공헌합니다.

【특징】

✧ 1.1” & 1” 센서 대응
✧ 광학배율 1.0x/1.5x/2.0x/3.0x/4.0x 5 기종 라인업
✧ 전 기종 가변조리개 대응으로 피사계심도 조절 가능
✧ 동축낙사조명

【용도】

반도체검사, Wafer 검사, 그 외

【주요 사양】

형식	WD	O/I	광학배율	대응 센서 사이즈
VS-THV1-110CO/S-SWIR	111.1mm	259.6mm	1.0x	1″
VS-THV1.5-110CO/S-SWIR	110.4mm	259.3mm	1.5x	1.1″
VS-THV2-110CO/S-SWIR	110.4mm	294.9mm	2.0x	1″
VS-THV3-110CO/S-SWIR	111.2mm	325.0mm	3.0x	1.1”
VS-THV4-110CO/S-SWIR	110.4mm	349.9mm	4.0x	1.1”

【판매 지역】

글로벌

광고 홍보 관계 문의처
VS Technology HQ +81-3-3560-6668
고객 문의처
판매 거점 네트워크를 참조 하시기 바랍니다.